

Micron Technology 提供新款單面 DDR3 DRAM 模組樣品

TE Connectivity 推出與單面 DDR3 模組相容的連接器

技術領導採用薄型模組和連接器解決方案瞄準超薄型計算市場

愛達荷州博伊西，2013 年 2 月 8 日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界領先的先進半導體解決方案供應商之一 Micron Technology, Inc.(納斯達克股票代碼：MU) 和世界領先的連接器供應商 TE Connectivity (TE)(紐約證券交易所股票代碼：TEL) 今日宣佈單面 SODIMM 和小尺寸 單面、雙倍資料傳輸率 3 (DDR3) SODIMM 連接器解決方案開始供貨，以抓住迅速發展的超極本 Ultrabook (TM) 設備、可折疊設備、平板電腦、和其他輕型薄型設備的新興市場。該新款單面 SODIMM 由 Micron 開發，在主機板的正面或背面放置有元件（但不會同時在兩面置放），旨在向超薄計算市場提供薄型存儲解決方案。在與 TE 的單面 DDR3 SODIMM 連接器配合使用時，整個解決方案從主機板向上的總 z 軸高度僅僅為 3 毫米，比標準 SODIMM 解決方案的 4.6 毫米節省了 35% 的空間。

Micron 目前供貨的單面 SODIMM 容量為 4GB，單行排列，且為 x8 配置。除了高度降低之外，這新的模組還採用了 30 納米 DDR3L-RS 元件，該元件在待機時的功耗比標準 DDR3 還低。此外，該單面 SODIMM 的每只管腳均與當前的 DDR3 模組相容，這使其可與現有的 DDR3 SODIMM 連接器與舊版相容。

“由於目前超薄設備市場的深度和廣度，結合用戶對優雅、輕型設計的要求，Micron 的目標是提供能滿足便攜性、電池壽命和專業能源需求的解決方案”，Micron 計算設備業務開發總監 Kris Kido 說道。“Micron 單面 SODIMM 獨特的外形尺寸可滿足這些需求，並將在這個日益增長的領域中引領未來發展的方向”。

TE 的工程師們已設計了新款單面 DDR3 SODIMM 連接器以便為高速資料應用提供卓越的性能。該連接器的主要特點是：與類似的薄型連接器相比，高度降低了 35%。這使得最終產品的高度降低了 5-10%。也使主機板陰影面積減少了 156 平方毫米，對常見的雙插槽器件而言，則減少了 312 平方毫米的面積。該 DDR3 SODIMM 連接器可接納符合 JEDEC MO268 行業標準的模組，並提供標準類型和反向類型。

“很明顯，我們所看到薄型設備，從超極本 Ultrabook (TM) 設備到平板電腦，變得越來越薄、越來越優雅”，TE 消費設備產品經理 Hook Chang 說道。“在過去，存儲設備電路的小型化通常以犧牲可靠性為代價。我們的 DDR3 SODIMM 連接器解決了這個問題，可確保耐久的連接以優化設備的功能性、速度和可用性。Micron Technology 和我們共同承諾，向客戶提供優質可靠、高性價比的解決方案以使產品性能最佳化”。

產品提供

Micron 現在可提供單面 SODIMM 器件的樣品，計畫 2013 年春季進行批量生產。

TE Connectivity 現在可提供單面 SODIMM 連接器的樣品，計畫 2013 年 6 月進行批量生產。

Micron 超薄記憶體: 擁抱未來

Micron 以全球視角的眼光審視行動計算裝置市場，將自己的產品恰當地定位于支援超薄應用的增長。我們品種齊全的各類產品，包括業界領先的 DRAM、固態硬碟和 NOR 快閃記憶體盤，使高性能超薄型計算設備在彈指一揮間便開始火爆功能。採用了 Micron 的記憶體和存儲解決方案，功能強大、快速回應計算、即開即關、應用程式快速載入、超薄超輕型設計、更長的電池壽命以及電池節能均有可能。

關於 Micron

Micron Technology, Inc., 是全球領先的先進半導體解決方案供應商之一。通過它遍佈全球的運營，Micron 為先進的計算、使用者、網路、嵌入式和移動產品生產和銷售全套固態硬碟、DRAM、NAND 和 NOR 快閃記憶體，以及其他創新的記憶體技術、封裝方案和半導體系統。Micron 的普通股在納斯達克上市交易，代碼是 MU。欲瞭解有關美光科技公司的更多資訊，請訪問 www.micron.com。

Micron Technology, Inc. 徽標位於 <http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6950>

關於 TE Connectivity

TE Connectivity (紐約證券交易所股票代碼:TEL)擁有 130 億資本，是世界連接器領先廠家。該公司為世界領先行業，包括汽車、能源、工業、寬頻通信、消費類設備、醫療保健、航太、防衛等，設計和製造電子連接的核心產品。TE Connectivity 長期致力於革新和卓越的工程設計，幫助

客戶解決關於高效節能、可靠通信、日益增長的生產力等方面的需求。該公司在 50 多個國家中雇用有近 9 萬名員工，每天為全世界製造可靠的連接。欲與該公司聯繫，請訪問 www.TE.com。

(C)2013 Micron Technology, Inc.版權所有。資料若有修改，恕不另行通知。Micron 和 Micron orbit 徽標是 Micron Technology, Inc.的商標。所有其他商標均為各自所有者擁有。本新聞稿包含關於單面 SODIMM 產品生產的某些前瞻性陳述。實際情況或結果可能與前瞻性陳述中包括的內容不同。請參考 Micron 和證券交易委員會定期發佈的匯總檔，特別是 Micron 最新的 10-K 和 10-Q 表。這些檔包含並確定導致匯總檔中的內容與前瞻性陳述不同的重要因素（見“某些因素”）。儘管我們認為前瞻性陳述中所反映的預期是合理的，但我們不能保證其未來結果、活動程度、性能或成就。

聯繫資訊: Zeno Group for Micron

Mary Ellen Ynes

maryellen.ynes@zenogroup.com

650-801-7954

TE Connectivity

Jeanne Wu

jeanne.wu@te.com

+86-21-33980729